



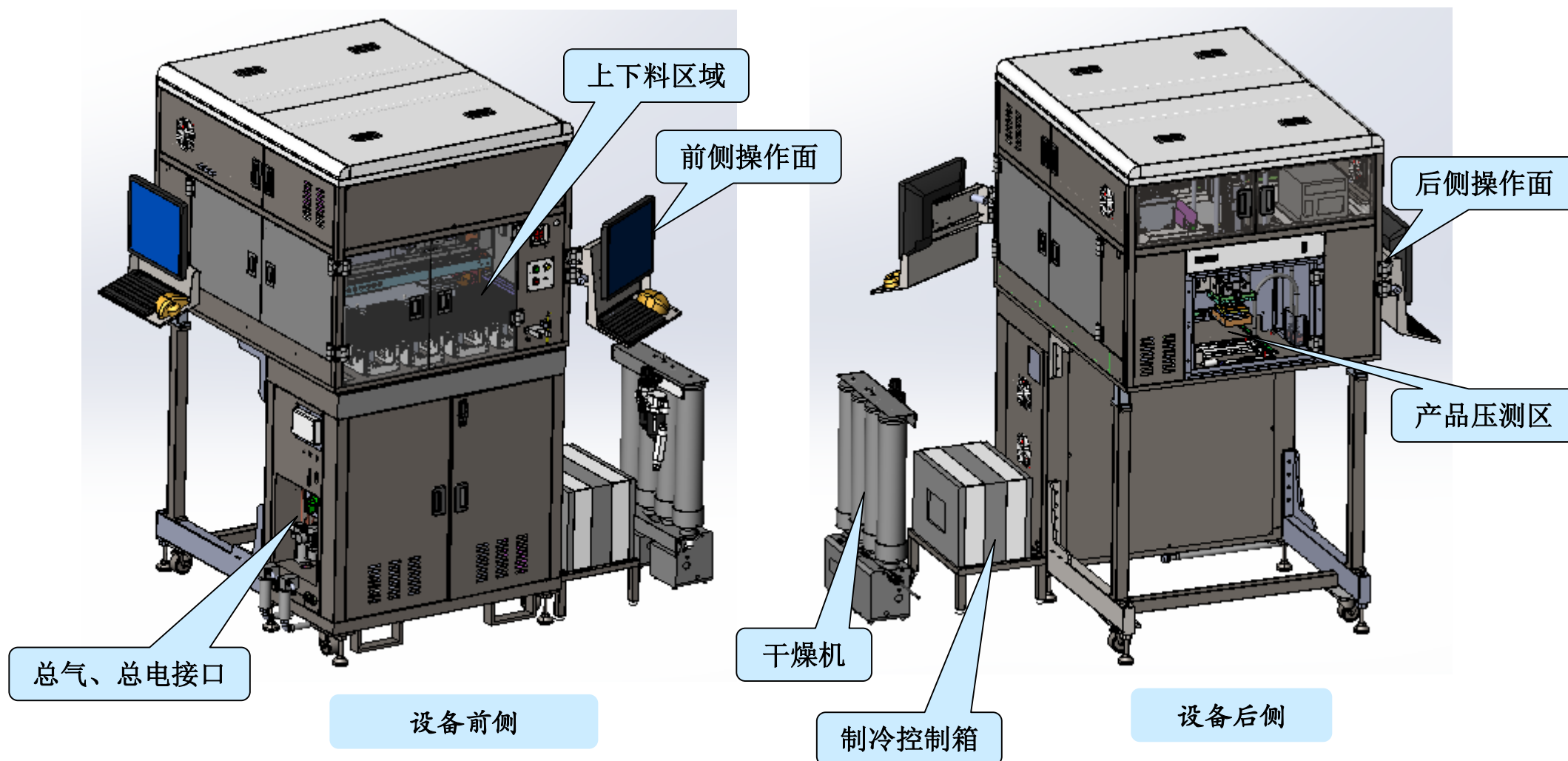
GIT1202DT MINI 三温 handler 方案

2024年07月

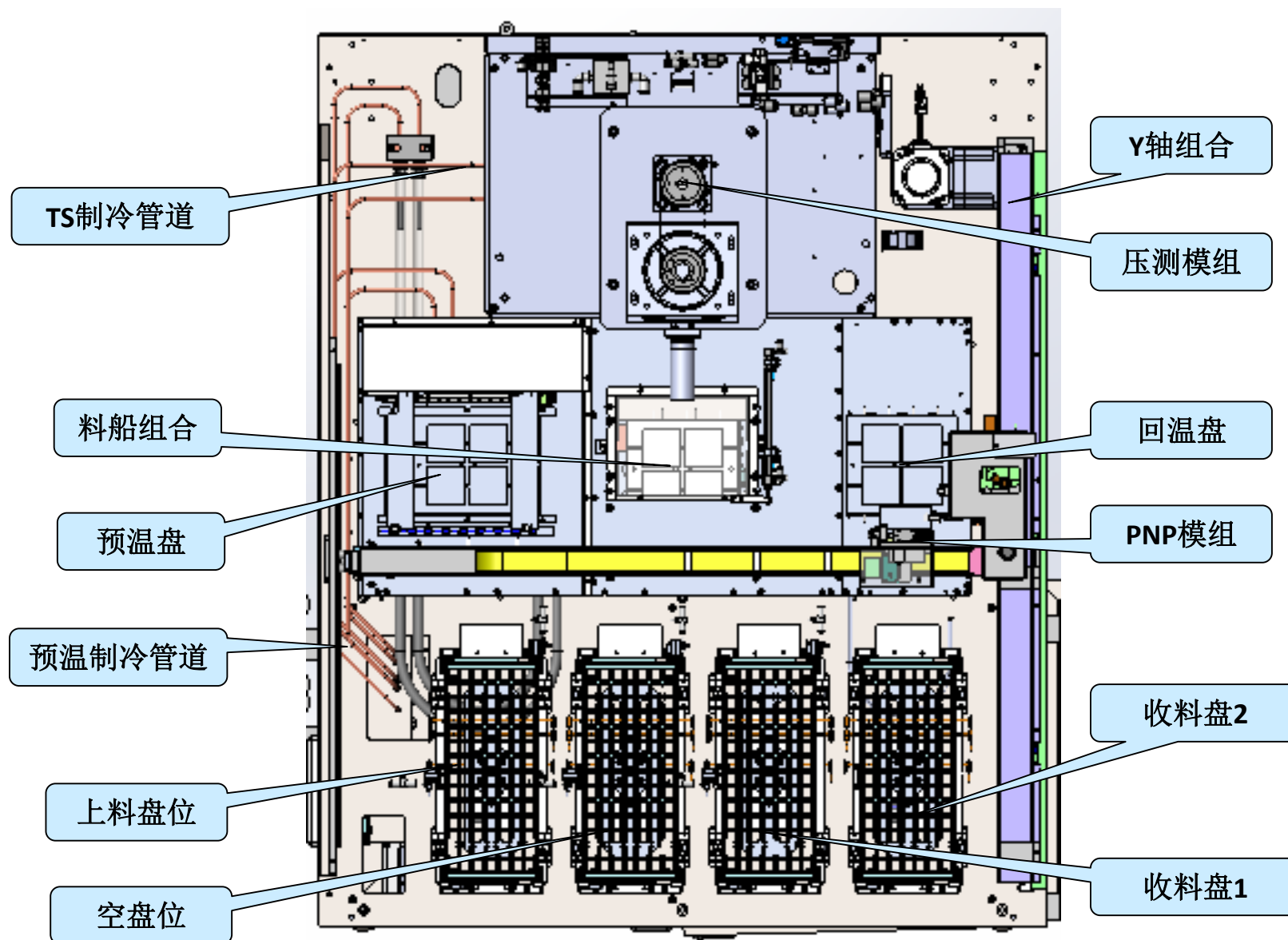
1、设备外观



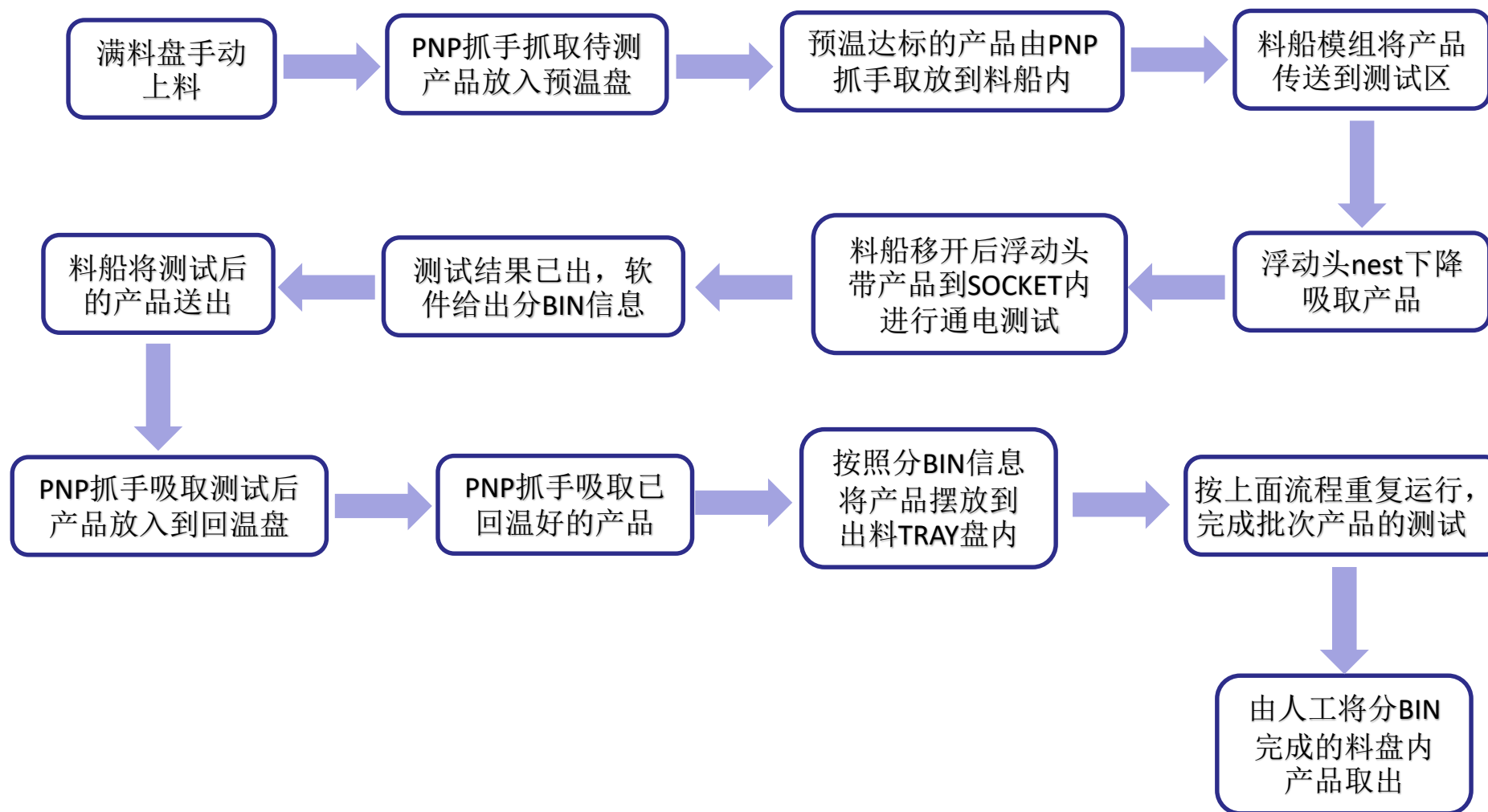
设备外形尺寸：
L1050*W1290*H2050mm



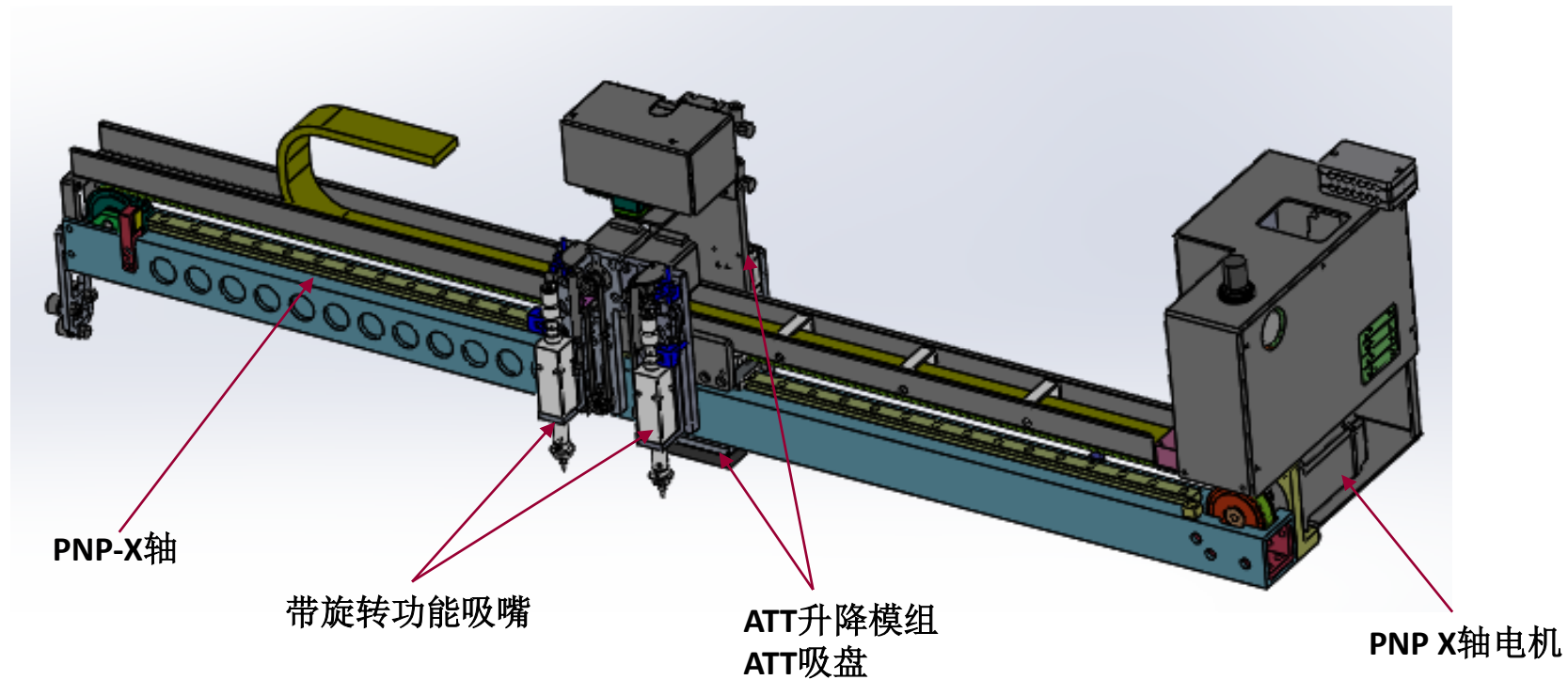
2、设备布局



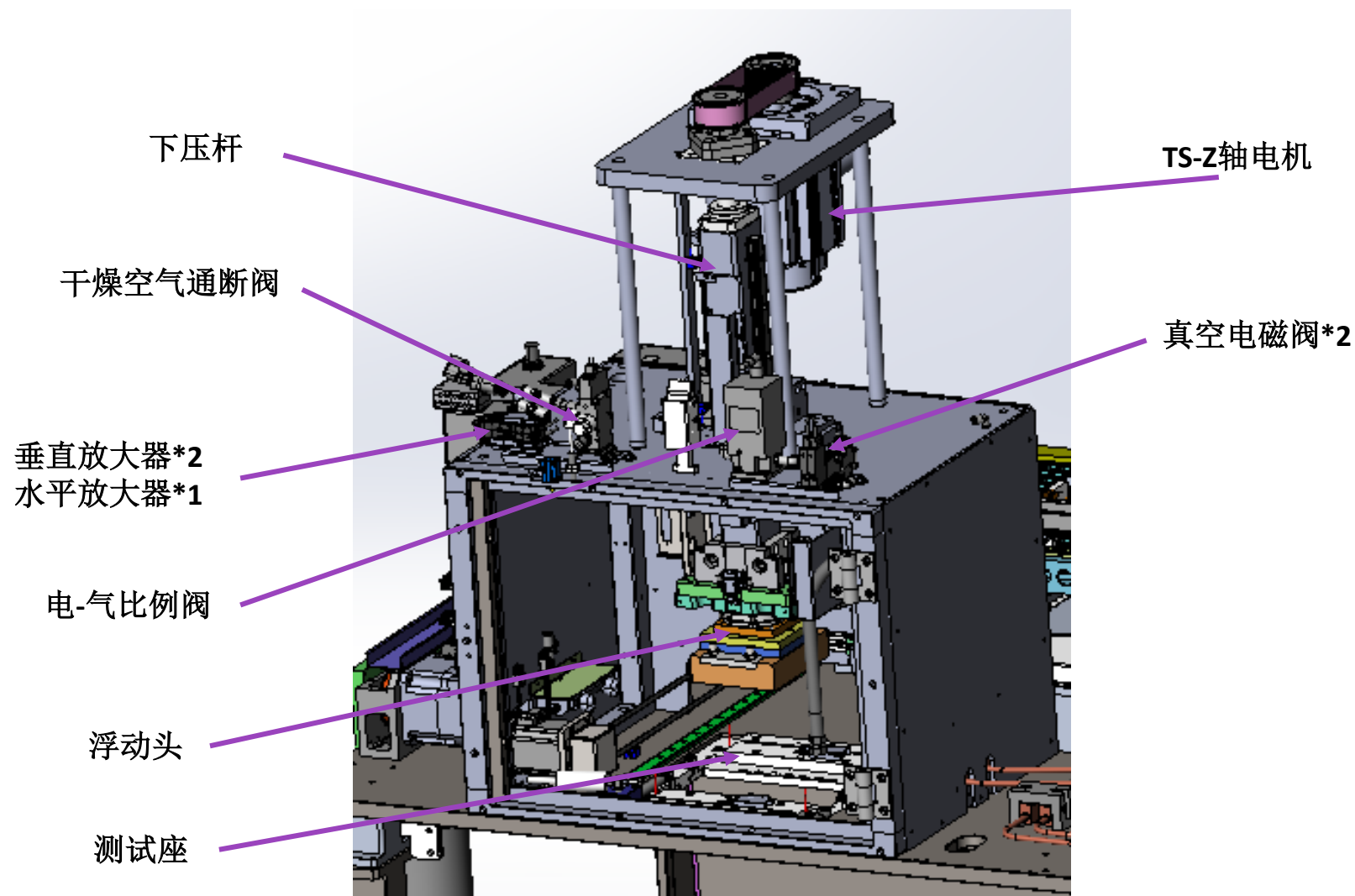
3、设备流程图



4、PNP+ATT模组



5、TS模组



6、技术参数一

- ◆ 尺寸: 1050 (L) *1290 (W) *2050 (H)
- ◆ 重量 : 900 kg
- ◆ 控制及加热功率: AC 220V/40A 50Hz;
- ◆ 冷媒机功率: AC 220V/40A 50Hz
- ◆ 干燥空气: 气压: 7 kg/cm² ; 流量: < 1200 L/min;
- ◆ 工位及芯片尺寸: Dual Site: Min=3*3mm ~25*25mm (选配1X4mm)
Dual Site: Max=25*25mm~50*50mm
Single Site: Max=50*50~110 *110mm
- ◆ 兼容芯片封装: QFN,QFP,TSOP,BGA,SIP,PLCC,LGA,CSP,PGA etc.
- ◆ 预温盘尺寸: W 140mm* D 160mm
- ◆ 料盘规格: JEDEC Std.
- ◆ 温度模式: 常温/高温/低温
- ◆ 抓手模式: 1X2 pick head
- ◆ UPH: 常温: ≤ 500 pcs/h
• (Changeover kit 1×2, Tray Form 14*36 , QFN 4×4mm, test time=0s)
• 低温/高温: ≤ 350 pcs/h
• (Changeover kit 1×2, Tray Form 14*36 , QFN 4×4mm, test time=0s)
- ◆ Index Time: ≤ 15S
- ◆ 产品外观损伤: 试跑1K产品, 无分选机引起的外观损伤
- ◆ 良率: > 99.6% (OS好品测试)
- ◆ 分bin准确率: 100%

7、技术参数二



- ◆ 旋转角度： 顺时针/逆时针 (90/180/270°)
- ◆ 测试压力： Min: 30kg, Max: 240kg
- ◆ 压测接触模式： Direct Contact/Drop Contact
- ◆ 测试工位： 可兼容单site、1X2,
- ◆ KIT更换时长： 小于20min, 可兼容Epson、Hontec Kit
- ◆ 测试区尺寸： 1000*1000*1060mm
- ◆ 测试座开口尺寸： 224mm*140mm
- ◆ 温度范围： -55℃-150℃ , ±2℃ ; (选配175℃)
- ◆ ATC能力： -55℃ @60W, -40℃ @100W, -5℃ @200W
25℃ @250W, 85℃~125℃ @350W

- ◆ 加热速度： -55℃~25℃ ≤150秒; -40℃~25℃ ≤100秒; 25℃~125℃ ≤200秒
- ◆ 制冷速度： 125℃~25℃ ≤600秒; 25℃~-40℃ ≤400秒; 25℃~-55℃ ≤800秒
- ◆ 冷水机尺寸： L595 * W380 * H980 mm
- ◆ 制冷设备： 2台
- ◆ 高低温空气设备： L950 * W500 * H1180 mm (选配)
- ◆ 视觉检测： 二维码检测 (选配) ; OCR检测 (选配)
- ◆ 露点感应器： 1组
- ◆ 离子风扇： 3组
- ◆ 防静电要求： Grounding resistance < 1Ω; ±1000V → ±10V < 10s

8、冷水机及高低温空气机



冷水机
L770*W550*H1030



高低温空气机（选配）
L950*W500*H1180



深圳格芯集成电路装备有限公司

Shenzhen Grand Innosys Corporation

公司地址：深圳市坪山区翠景路33号格兰达装备产业园

联系电话：0755-8931 8001

三温自动分选机介绍



名称	指标
支持封装类型	DIP、SOP、TSOP、TQFP、CQFP、CBGA、CPGA、BGA、LGA、PLCC、CSP、QFP、QFN多种封装形式；
支持产品封装尺寸	采用pick&place结构，可支持的封装尺寸范围：From 3x3 to 110x110 mm
抓手模式	1X2 pick head
Tray形式：	Tray盘形式适应JEDEC封装标准
进料/出料方式	自动 TRAY 盘进料/出料，自动进料/出料区最多可放 Tray 盘数不小于 8 个
换盘	进出料盘装置由四组装置组成，支持自动换盘
操作方式	支持自动和手动模式。
工位	共2个测试工位数 可实现电路单工位独立测试、双工位并行测试；
测试种类	设备正常做FT测试，更换测试座后，可支持SLT测试。
温控	整机温控系统采用主动式控温；每个模块采用接触式控温并有温度传感器，温度数值显示到设备屏幕上
温度传感器	测试头模组均配有高精度温度传感器，且温度传感器的值可以实时显示数据
温度精度	在高温到低温范围内，测试区温度点可调数值 $\leq 0.1^{\circ}\text{C}$ ；测试区温度精度允许偏差值为 $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ ；能在测试区域保持温度；
测试区温度范围	测试温度范围： $-55^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}$ ；温度控制精度： $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ，温度均匀性 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ；
制冷方式	包含测试、机械手、制热制冷及必要的环境条件辅助保障模块，采用冷媒直冷的方式降温
卡料率	$\leq 1/1000$ 。
下压力	$\geq 240\text{KG}$ 。
UPH	常温 $\geq 660\text{PCS/H}$ ，高温 $\geq 460\text{PCS/H}$ ，低温 $\geq 360\text{PCS/H}$ ，（1*2模式，测试时间为0时）
通讯	可与生产系统对接，支持标准SECS-GEM协议

